

**Konferenz
der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder
am 5. Juni 2025 in Berlin**

Beschluss

TOP 1.7.3 Mikroelektronik, European Chips Act (ECA)

Angesichts globaler handelspolitischer Herausforderungen kommt der Halbleiterindustrie eine Schlüsselrolle bei der Stärkung der technologischen Souveränität Deutschlands und der Europäischen Union zu. Sie ist Treiber für Innovationen und unverzichtbare Basistechnologie in anderen Branchen wie der Automobilindustrie, der Verteidigungsindustrie, der Künstlichen Intelligenz und der Energiewirtschaft.

1. Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder begrüßen das Bekenntnis der Bundesregierung, Deutschland unter Nutzung der bestehenden europäischen beihilferechtlichen Rahmenbedingungen (Important Project of Common European Interest – IPCEI, European Chips Act – ECA) zu einem führenden Standort für Mikroelektronik ausbauen zu wollen. Dabei kommt der industriellen Halbleiterfertigung als zentralem Bestandteil der Mikroelektronik eine besondere Priorität zu, da sie die Voraussetzung für strategische Souveränität, Hochtechnologieanwendungen und regionale Wertschöpfungsketten bildet. Sie wollen gemeinsam mit der Bundesregierung die Mikroelektronikindustrie weiter proaktiv unterstützen, insbesondere in den Bereichen der Halbleiter-Wertschöpfungskette, in denen globale Marktverzerrungen vorliegen und die zur Steigerung der Resilienz beitragen.
2. Die Mikroelektronikindustrie ist durch dynamische und schnelle Innovations- und Produktzyklen geprägt, denen die Dauer der aktuellen Verfahren im Rahmen von IPCEI oder ECA nicht gerecht wird. Der Vorlauf für die Verfahren, die Teilnahmebedingungen und die Entscheidungsprozesse in den Verfahren sind zu langwierig und zu komplex und erschweren es damit den Unternehmen, in

effektiver Weise zu partizipieren. Sie werden damit den Bedarfen der Mikroelektronikindustrie sowie den Ambitionen Deutschlands und der Europäischen Union nicht gerecht. Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder setzen sich gemeinsam mit dem Bund für eine Entbürokratisierung, Standardisierung und Parallelisierung der Prozesse auf allen Ebenen ein. Handlungsleitend ist dabei das Prinzip „weniger Nachweis, mehr Kontrolle“. Die Beschleunigung von Beihilfe- und Genehmigungsverfahren auf europäischer Ebene ist erforderlich, um ein investorenfreundliches Ansiedlungsklima zu schaffen.

3. Durch die aktuellen geopolitischen Entwicklungen bedarf es einer zügigen Fortschreibung des European Chips Act. Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder fordern daher die Bundesregierung auf, sich gegenüber der Europäischen Kommission für folgende Anpassungen einzusetzen:
 - a. Vereinfachung der Beihilfebedingungen entsprechend den Bedürfnissen der europäischen Wirtschaft und unter Berücksichtigung sicherheitspolitischer Erwägungen über die gesamte Bandbreite von Chiptechnologien und Wertschöpfungsketten,
 - b. Berücksichtigung der infrastrukturellen Voraussetzungen und einer stärkeren Verzahnung der Produktion mit Forschung, strategischen Zulieferern entlang der vorgelagerten Wertschöpfungskette und Fachkräfteentwicklung bei der Unterstützung der Mikroelektronikindustrie,
 - c. Untersetzung des European Chips Act mit eigenen europäischen Budgetmitteln im Rahmen des Mehrjährigen Finanzrahmen ab 2028,
 - d. Stärkung der Höchstleistungschips für KI-Anwendungen, die im bisherigen Chips Act nicht ausreichend berücksichtigt wurden, um die Marktreife der neuen Hardware-Generation zu beschleunigen und den Aufbau entsprechender Chipfabriken zu fördern.
 - e. Weiterentwicklung des EU-Chip Acts entlang der Empfehlungen der European Semiconductor Regions Alliance (ESRA) insbesondere mit dem Ziel, regionale Innovationsökosysteme und Cluster gezielt zu stärken sowie den Zugang für KMU und Startups zu den Förderinstrumenten des ECA zu erleichtern.

4. Die Länder investieren erheblich in die infrastrukturellen Ökosysteme der Halbleitervorhaben und die Fachkräftesicherung. Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder bitten den Bund, sich in einer gemeinsamen Kraftanstrengung an den Investitionen zu beteiligen, um Skalierungseffekte voll auszunutzen und Deutschland international leistungs- und konkurrenzfähig zu halten.
5. Die Länder appellieren an den Bund, aufgrund der Bedeutung der Mikroelektronik für die europäische Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit die Kofinanzierung der Länder bei entsprechenden IPCEI und ECA-Projekten möglichst gering zu halten.
6. Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder begrüßen die Bestrebungen des Bundes, strategische Ziele für die weitere Entwicklung und Unterstützung der Mikroelektronik, unter besonderer Berücksichtigung der KMU, zu formulieren. Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder bitten den Bund, die Strategie auf Bundes- und europäischer Ebene zeitnah auf den Weg zu bringen, so schlank und flexibel wie möglich zu gestalten und die Länder bei der Umsetzung eng einzubinden.